

اثر چگالی جریان رسوب‌دهی بر خواص پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Cu/Al₂O₃*

حامد صفایی^(۱) مرتضی علیزاده^(۲) عرفان صلاحی نژاد^(۳)

چکیده در این تحقیق، پوشش‌های کامپوزیتی Ni-Cu/Al₂O₃ به روش رسوب‌دهی الکتریکی از حمام سیترات-آمونیاکی ایجاد شدند. اثر چگالی جریان بر مورفولوژی، ترکیب شیمیایی، سختی و رفتار خوردگی پوشش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. مورفولوژی، ترکیب شیمیایی و رفتار خوردگی پوشش‌ها به ترتیب توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، آنالیز طیفسنجی تفکیک انرژی پرتوی ایکس و آزمون پلاریزاسیون تافل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییر در چگالی جریان رسوب‌دهی باعث تغییر در ترکیب شیمیایی و مورفولوژی پوشش‌ها می‌شود. همچنین، با افزایش چگالی جریان ریزسختی پوشش‌ها ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد، درحالی‌که مقاومت به خوردگی پوشش‌ها کاهش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی پوشش‌های کامپوزیتی، چگالی جریان، ریزساختار، ریزسختی، رفتار خوردگی.

Effect of Current Density on Properties of Ni-Cu/Al₂O₃ Composite Coatings

H. Safaei M. Alizadeh E. Salahinejad

Abstract In this research, Ni-Cu/Al₂O₃ composite coatings were prepared by electrodeposition from a citrate-ammonia bath; and the effect of deposition current density on the microstructure, hardness and electrochemical corrosion behaviors of the coatings was studied. The results showed that the morphology and composition of the coatings are changed with the current density. Also, by increasing the current density, the microhardness of the coatings is enhanced and then decreased; whereas the corrosion resistance of the prepared coatings is progressively decreased.

Keywords Composite Coatings, Current density, Microstructure, Micro-hardness, Corrosion behavior.

* نسخه نخست مقاله در تاریخ ۹۶/۱/۲۰ و نسخه پایانی آن در تاریخ ۹۶/۶/۶ به دفتر نشریه رسیده است.

(۱) دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شیراز.

(۲) نویسنده مسئول: دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شیراز.

(۳) دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.

مقدمه

سطح یکی از مهم‌ترین بخش‌های قطعات و سازه‌های مهندسی است. امروزه به‌خوبی آشکار شده است که عمده‌ازکارافتادگی‌ها ناشی از پدیده‌هایی همچون سایش، خوردگی، خستگی و شکست قطعات مهندسی از سطح شروع می‌شود [1]. اعمال پوشش فلزی محافظ بر روی سطح قطعات یک روش مناسب جهت بهبود مقاومت سطحی آن‌ها است و امکان استفاده از این قطعات را در محیط‌های مخرب میسر می‌سازد [1]. از پوشش‌های فلزی خالص و آلیاژی به‌طور گسترده‌ای برای بهبود مقاومت در برابر خوردگی و خواص مکانیکی قطعات و نیز به‌منظور اهداف تزئینی استفاده می‌شود [2]. وارد کردن نانو ذرات سخت اکسیدی و سرامیکی همچون Al_2O_3 ، TiO_2 ، SiO_2 و SiC در زمینه پوشش‌های آلیاژی فلزی و ایجاد پوشش کامپوزیتی می‌تواند برخی از خواص ذکر شده مانند مقاومت به خوردگی و خواص مکانیکی را در مقایسه با پوشش فلزات خالص و آلیاژها بهبود بخشد [3,4]. پوشش‌های کامپوزیتی توسط روش‌های رسوب‌دهی در خلأ (رسوب فیزیکی بخار و رسوب شیمیایی بخار)، پیرولیز پاششی و رسوب‌دهی الکتریکی تولید می‌شوند [2]. روش رسوب‌دهی الکتریکی یکی از مناسب‌ترین روش‌های تولید پوشش‌های کامپوزیتی است [3]. این روش دارای مزایایی همچون هزینه کم تجهیزات اولیه، سرعت بالای تولید، امکان صنعتی سازی و امکان انجام فرایند در دما و فشار محیط است و به همین دلیل مورد توجه محققان قرار گرفته است [5-10]. خواص پوشش‌های به‌دست‌آمده توسط روش رسوب‌دهی الکتریکی به میزان قابل توجهی تحت تأثیر پارامترهای این روش مانند دما، پی اچ حمام، چگالی جریان اعمالی، نوع جریان (مستقیم، پالسی و پالس معکوس)، پتانسیل رسوب‌دهی، شرایط انتقال جرم (نوع و نرخ هم زدن محلول) و ترکیب شیمیایی الکترولیت است [10,11]. از بین پارامترهای ذکر شده، چگالی جریان یک پارامتر بسیار مهم در روش رسوب‌دهی الکتریکی است. این پارامتر تأثیر بسزایی بر نرخ رسوب‌دهی الکتریکی، ترکیب شیمیایی، ریزساختار و خواص پوشش به‌دست‌آمده

توسط این روش دارد [12]. با توجه به مطالعات صورت گرفته و بررسی‌های انجام‌شده، تاکنون پوشش‌های زمینه آلیاژی $Ni-Cu/Al_2O_3$ تولید نشده است. در تحقیق حاضر، اثر چگالی جریان رسوب‌دهی بر مقدار هم رسوبی نانو ذرات در پوشش، ریزساختار، ریزسختی و مقاومت به خوردگی پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu/Al_2O_3$ مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش تحقیق

در این تحقیق، برای تولید پوشش‌های کامپوزیتی زمینه آلیاژی نیکل-مس-اکسید آلومینیوم از روش رسوب‌دهی الکتریکی استفاده شد. فلز نیکل با ابعاد $۲/۵ \times ۰/۳ \times ۴$ سانتی‌متر به‌عنوان آند مصرفی و ورق فولاد ساده کربنی با ابعاد $۰/۱۵ \times ۱/۲ \times ۱/۷$ سانتی‌متر به‌عنوان کاتد استفاده گردید. آند و کاتد به‌صورت عمودی در فاصله ۲ سانتی‌متر از یکدیگر در محلول الکترولیت تنظیم شدند. از حمام سترات-آمونیاکی به‌عنوان حمام پوشش دهی استفاده گردید. جدول (۱) و (۲) به ترتیب ترکیب شیمیایی حمام پوشش دهی و شرایط رسوب‌دهی الکتریکی را نشان می‌دهد. به‌منظور آماده‌سازی سطحی، ابتدا سطح نمونه‌های فولادی توسط کاغذ سنباده‌های ۱۸۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۸۰۰ سنباده‌زنی شد. سپس با هدف تمیز کردن سطح نمونه‌ها از هرگونه چربی و آلودگی نمونه‌ها به مدت ۳ دقیقه در محلول استون در دستگاه آلتراسونیک قرار داده شدند. در ادامه عملیات اسید شویی نمونه‌ها در محلول اسید نیتریک رقیق به‌منظور فعال‌سازی سطح نمونه‌ها به مدت ۳۰ ثانیه انجام گرفت و سپس نمونه‌ها با آب مقطر شسته و خشک شدند و بلافاصله تحت عملیات رسوب‌دهی الکتریکی قرار گرفتند. برای جلوگیری از به هم چسبیدن نانو ذرات اکسید آلومینیوم در حین فرایند رسوب‌دهی و توزیع بهتر آن‌ها در حمام آبکاری، محلول به مدت ۲۴ ساعت با سرعت ۳۶۰ دور در دقیقه توسط همزن مغناطیسی به هم زده شد درحالی‌که از ماده سدیم دودسیل سولفات به‌عنوان پایدارکننده به مقدار ۰/۱ گرم بر لیتر استفاده شد. از آمونیا جهت تنظیم مقدار pH الکترولیت استفاده شد. جهت کاهش اختلاف پتانسیل و نیز هم رسوبی مس و نیکل از سدیم

در آن الکتروود مرجع از جنس نقره/کلرید نقره و الکتروود کمکی از جنس پلاتین بود استفاده گردید. نرخ روبش پتانسیل ۵ میلی ولت بر ثانیه و پله‌های تغییر پتانسیل انتخابی ۵ میلی ولت در نظر گرفته شد.

نتایج و بحث

بررسی اثر چگالی جریان رسوب‌دهی بر ترکیب شیمیایی زمینه پوشش‌های کامپوزیتی تولیدشده

چگالی جریان یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین متغیرها در رسوب‌دهی الکتریکی است که بر نوع و خواص پوشش‌های تولیدشده اثر می‌گذارد [16]. اثر چگالی جریان بر ترکیب شیمیایی پوشش‌ها و میزان هم رسوبی نانو ذرات Al_2O_3 در پوشش کامپوزیتی نیکل-مس-اکسید آلومینیوم با غلظت ۲۰ گرم بر لیتر نانو ذرات اکسید آلومینیوم در حمام مورد بررسی قرار گرفت. در شکل (۱) نمودارهای به‌دست‌آمده از آنالیز کمی طیف‌سنجی تفکیک انرژی پوشش کامپوزیتی Ni-Cu- Al_2O_3 (20g/l) در چگالی جریان‌های مختلف آورده شده است. همان‌گونه که مشخص است حضور پیک‌های نیکل در ۰/۸ keV و ۷/۴ keV و پیک‌های مس نیز در ۰/۹ keV، ۸/۱ keV و ۸/۸ keV مؤید حضور نیکل و مس در این پوشش‌ها و همچنین پیک‌های آلومینیوم و اکسیژن نیز به ترتیب در ۱/۵ keV و ۰/۵۱ keV مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده حضور اکسید آلومینیوم در این پوشش‌هاست. به عبارتی، پوشش نیکل-مس-اکسید آلومینیوم در چگالی جریان‌های مختلف به‌طور موفقیت‌آمیز تولیدشده است. شکل (۲) درصد وزنی عناصر نیکل و مس در پوشش کامپوزیتی Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3 در چگالی جریان‌های مختلف را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود با افزایش چگالی جریان میزان درصد وزنی مس در پوشش کاهش پیدا می‌کند و درصد وزنی نیکل افزایش می‌یابد. در حمام سیترات-آمونیاکی، رسوب نیکل توسط انتقال بار روی سطح کاتد و رسوب مس توسط نفوذ یون‌های مس از داخل محلول الکتروولیت کنترل می‌شود [6,8]. با افزایش چگالی جریان رسوب‌دهی زمانی که نرخ انتقال بار زیاد می‌شود مقدار رسوب‌دهی الکتریکی نیکل به تناسب افزایش می‌یابد زیرا

سیترات به‌عنوان عامل کمپلکس‌کننده استفاده شد [13-15].

جدول (۱) ترکیب شیمیایی حمام پوشش‌دهی

غلظت (گرم بر لیتر)	ترکیب
۱۰۵	سولفات نیکل ($NiSO_4 \cdot 6H_2O$)
۲۴/۹۵	سولفات مس ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$)
۵۸/۸	تری سدیم سیترات ($Na_3C_6H_5O_7 \cdot 2H_2O$)
۰/۱	سدیم دو سولفات ($NaC_{12}H_{25}SO_4$)
۲۰	اکسید آلومینیوم (۲۰ نانومتر)

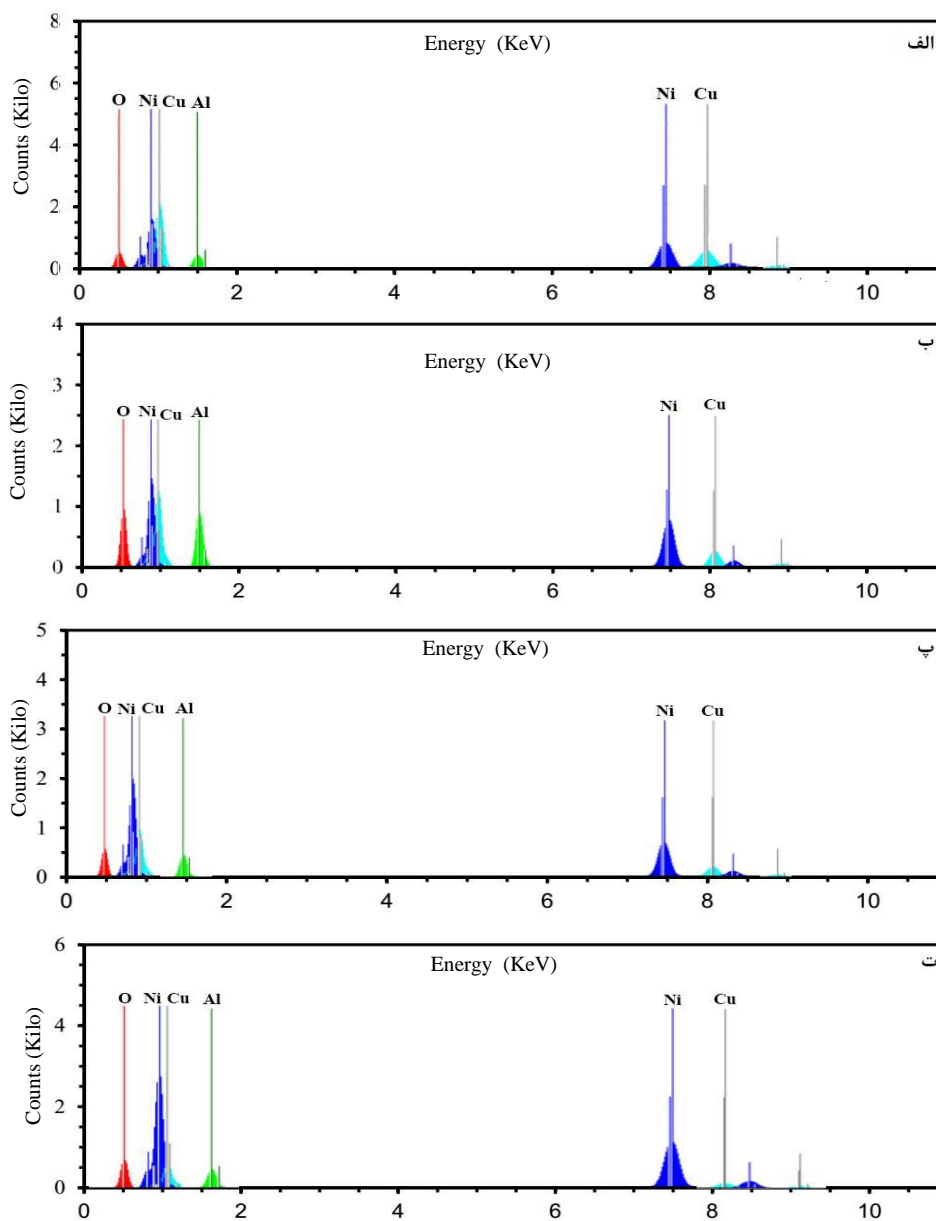
جدول (۲) شرایط رسوب‌دهی الکتریکی

چگالی جریان (آمپر بر دسی‌متر مربع)	۴ و ۱،۲،۳
دما (درجه سانتی‌گراد)	۳۵
سرعت هم زدن محلول (دور بر دقیقه)	۲۴۰
پی‌اچ	۴/۵
زمان آبکاری (دقیقه)	۹۰

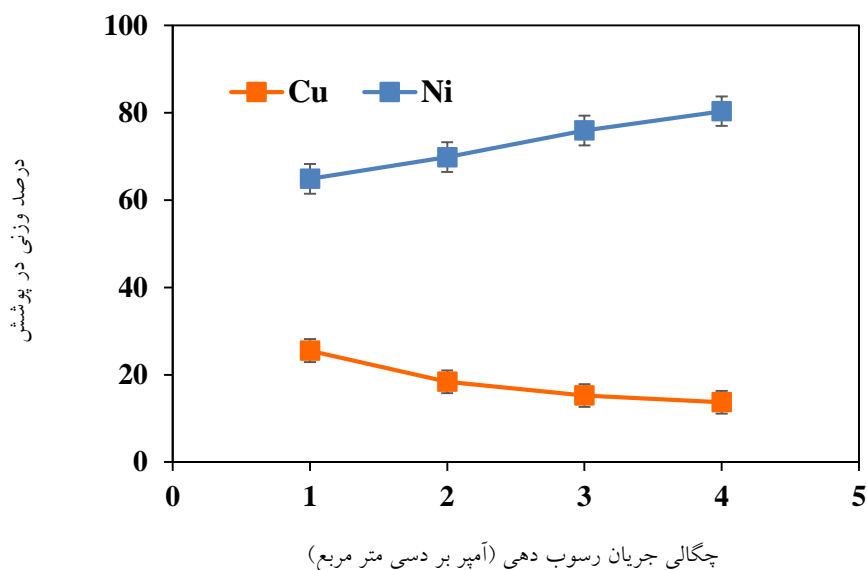
مورفولوژی سطحی و ریزساختار پوشش‌ها توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) با مدل VEGA\TESCAN-XMU مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری درصد وزنی عناصر تشکیل‌دهنده پوشش و همچنین بررسی نحوه توزیع عناصر فلزی و فاز تقویت‌کننده، به ترتیب از آنالیز طیف‌سنجی تفکیک انرژی پرتوی ایکس (EDS) و آنالیز عنصری سطح پوشش کامپوزیتی که توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی انجام می‌شود، استفاده شد. جهت اندازه‌گیری ریزسختی پوشش‌های تولیدی بر مبنای ویکرز از دستگاه ریزسختی سنج MH3 KOOPA (استاندارد ASTM E384) استفاده شد. نیرو اعمالی جهت انجام آزمون ۵۰ گرم و مدت زمان اعمال نیرو ۱۰ ثانیه انتخاب شد. جهت اطمینان از نتایج و به دست آوردن میزان خطای اندازه‌گیری، اندازه‌گیری‌ها در حداقل ۵ محل مختلف و تصادفی از سطح مقطع پوشش انجام و میانگین گزارش گردید. رفتار خوردگی این پوشش‌ها در محلول کلرید سدیم ۳/۵ درصد وزنی در دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد مورد بررسی قرار گرفت. آزمون‌های خوردگی با استفاده از دستگاه پتانسیواستات/گالوانواستات مدل Vertex ساخت شرکت Ivium هلند انجام شد. در اینجا از یک سل سه الکتروودی که

چگالی جریان و به دنبال آن افزایش نرخ انتقال بار در میزان نشست یون‌های نیکل و مس تفاوت ایجاد می‌شود. افزایش میزان نیکل و کاهش میزان مس در پوشش در توافق با تحقیقات قبلی است [6,10,17].

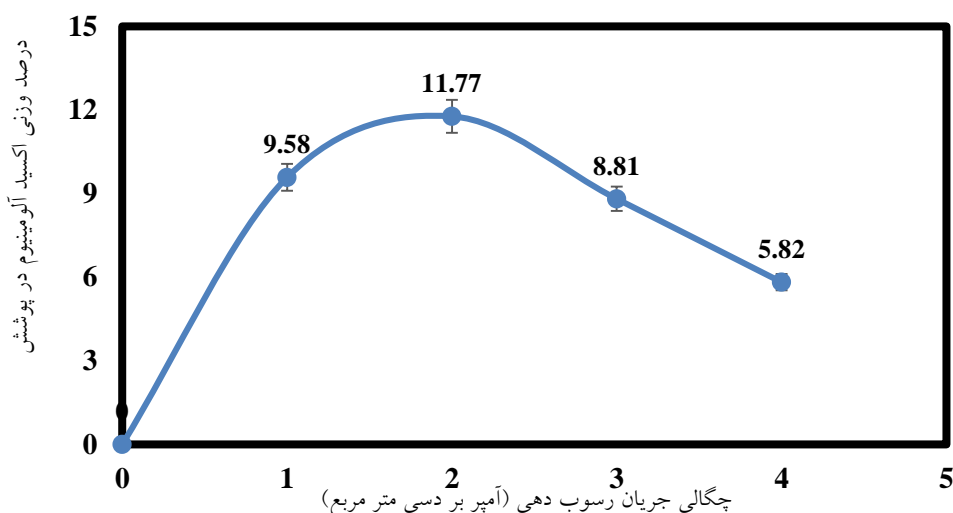
رسوب عنصر نیکل توسط انتقال بار کنترل می‌شود. نرخ نفوذ یون‌های مس حتی اگر نرخ انتقال بار زیاد شود تغییر نمی‌کند که این مطلب نشان می‌دهد که مقدار رسوب‌دهی الکتریکی مس نامتناسب با نرخ انتقال بار است [6,8]. در نتیجه با افزایش



شکل (۱) آنالیز EDS پوشش نانو کامپوزیتی $Ni-Cu-(20\text{ g/l}) Al_2O_3$ در چگالی جریان‌های: (الف) 1 A/dm^2 (ب) 2 A/dm^2 (پ) 3 A/dm^2 (ت) 4 A/dm^2



شکل (۲) تأثیر چگالی جریان رسوب دهی بر درصد وزنی عناصر نیکل و مس در پوشش



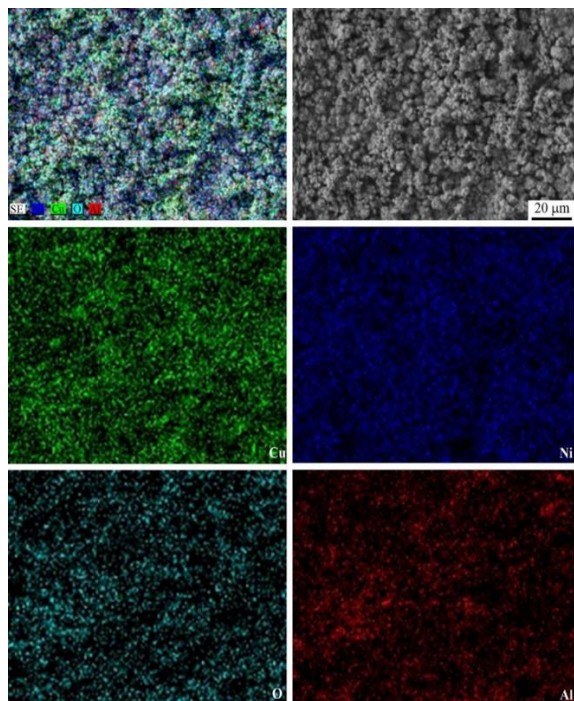
شکل (۳) تأثیر چگالی جریان رسوب دهی بر میزان هم رسوبی نانو ذرات اکسید آلومینیوم در پوشش

سپس با افزایش بیشتر چگالی جریان پوشش دهی، مقدار نانو ذرات آلومینا در پوشش کاهش می یابد. در چگالی جریان های پایین به دلیل سرعت کم انتقال یونها، ابر یونی مناسبی اطراف نانو ذرات احاطه نمی شود و این باعث می شود که جذب سطحی نانو ذرات به سطح کاتد به دلیل نیروی کولنی ضعیف، به اندازه کافی نباشد و از سطح کاتد جدا شوند [18]. همچنین در صورت جذب سطحی به کاتد نیز یون های لازم برای به دام انداختن نانو ذرات به دلیل کم

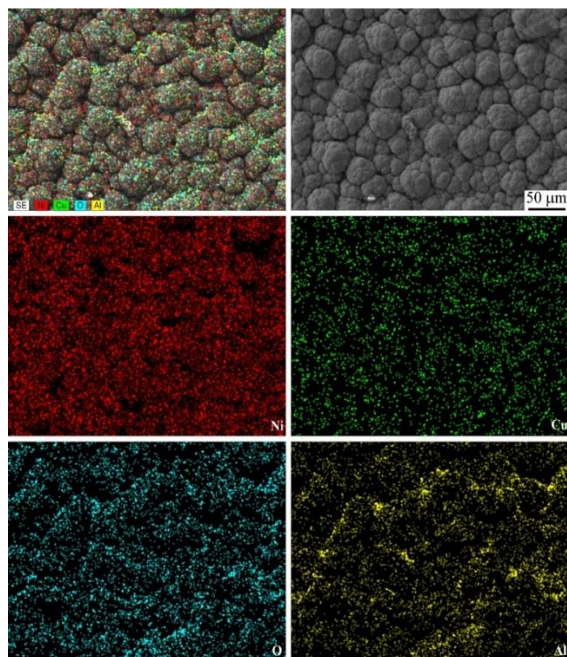
بررسی اثر چگالی جریان پوشش دهی بر میزان مشارکت نانو ذرات Al_2O_3 در پوشش

تأثیر چگالی جریان رسوب دهی بر میزان هم رسوبی نانو ذرات آلومینا در پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20\text{ g/l}) Al_2O_3$ در شکل (۳) نشان داده شده است. همان طور که از شکل (۳) مشخص می شود با افزایش چگالی جریان تا ۲ آمپر بر دسی متر مربع میزان هم رسوبی نانو ذرات آلومینا در پوشش افزایش می یابد و به یک مقدار ماکزیمم می رسد،

ذرات در داخل حمام از مهم ترین عوامل کاهش توده ای شدن نانو ذرات در حمام هستند [9,22].



شکل (۴) آنالیز عنصری سطح پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3$ در چگالی جریان رسوب دهی $1 A/dm^2$



شکل (۵) آنالیز عنصری سطح پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3$ در چگالی جریان رسوب دهی $4 A/dm^2$

بودن سرعت انتقال یونها کافی نبوده و باعث کاهش میزان نانو ذرات در چگالی جریان های پایین می شود [5]. با افزایش چگالی جریان به دلیل سرعت مناسب انتقال یونها و نیز ایجاد ابر یونی مناسب اطراف نانو ذرات اکسید آلومینیوم، این نانو ذرات بیشتر به سمت کاتد می روند و در آنجا توسط یون های فلزی احاطه می شوند [19]. افزایش بیشتر در چگالی جریان باعث منفی تر شدن سطح کاتد شده که باعث شتاب بیشتر یونها به سمت کاتد می شود و همچنین در چگالی جریان های بالاتر مقدار یون های نیکل بیشتری از سطح آند (آند از جنس نیکل خالص) آزاد شده که منجر به افزایش غلظت یون های نیکل در محلول می شود [5]. این دلایل باعث سرعت بیشتر یونها تحت چگالی جریان های بالاتر شده که در نهایت منجر به کاهش میزان مشارکت نانو ذرات در پوشش می شود [18,19]. علاوه بر این ها، با افزایش پلاریزاسیون در چگالی جریان های بالاتر، آزاد شدن هیدروژن بیشتر می شود و این باعث می شود که نانو ذرات ملحق شده به پوشش های کامپوزیتی کاهش یابد [5].

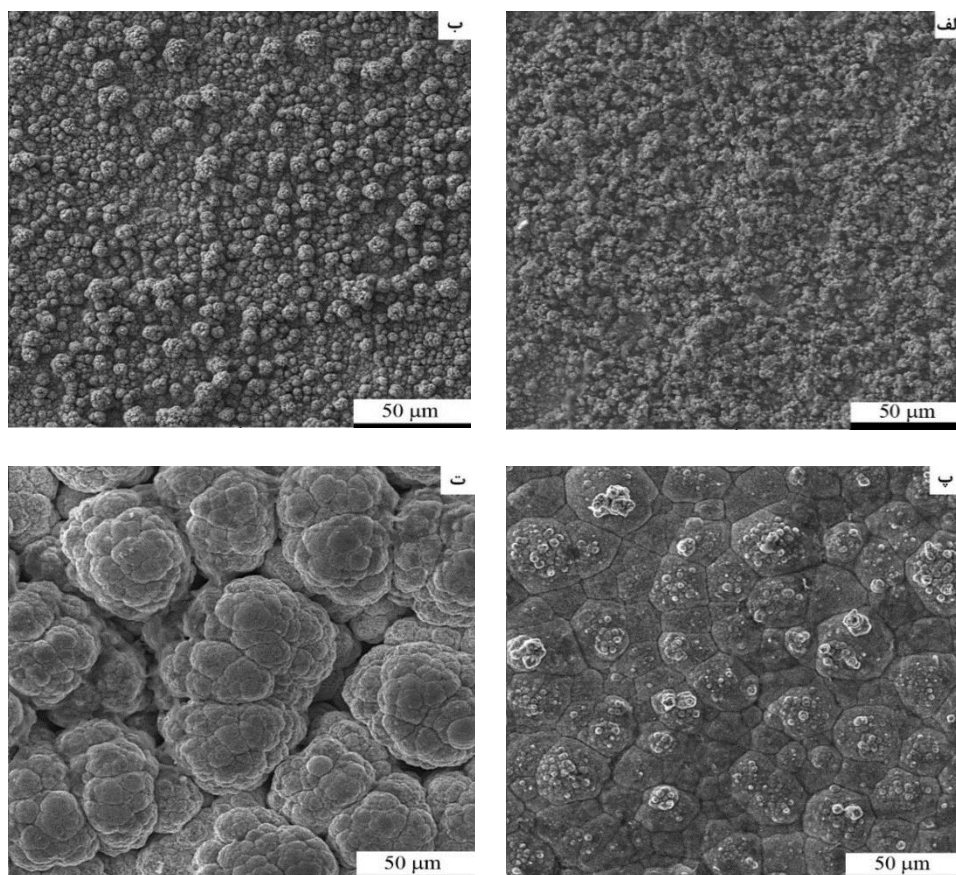
بررسی توزیع عناصر در سطح پوشش های تولید شده

جهت بررسی نحوه توزیع عناصر در سطح پوشش های تولیدی در چگالی جریان های مختلف آنالیز عنصری بر سطح نمونه های تولیدی صورت گرفت. شکل های (۴) و (۵) آنالیز عنصری سطح پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3$ تولید شده به ترتیب در چگالی جریان های ۱ و ۴ آمپر بر دسی متر مربع را نشان می دهد. همان طور که مشخص است توزیع عناصر آلیاژی نیکل و مس و همچنین نانو ذرات اکسید آلومینیوم در پوشش نسبتاً یکنواخت است. توزیع یکنواخت نانو ذرات فاز ثانویه می تواند نقش بسیار مهم و تأثیر گذاری در بهبود خواص مکانیکی پوشش همچون ریزسختی و نیز بهبود خواص خوردگی پوشش داشته باشد [20,21]. هرچه پراکندگی نانو ذرات در حمام آبکاری بهتر باشد و از توده ای شدن آنها جلوگیری شود توزیع آنها در پوشش نیز بهتر خواهد بود. عواملی چون سرعت هم زدن مناسب حین فرآیند رسوب دهی، استفاده از فعال کننده سطحی مناسب و استفاده از درصد بهینه نانو

در زمینه پوشش رخ می‌دهد که آن‌ها به صورت مناطق بیرون زده از زمینه نمایان شده‌اند. با افزایش چگالی جریان در سطح پوشش ساختاری گل کلمی مانند ظاهر می‌شود که با افزایش بیشتر چگالی جریان مناطق گل کلمی بیشتر رشد می‌کنند و دارای ابعاد بزرگ‌تری می‌شوند (شکل‌های ۶-پ و ت). در فرایند رسوب‌دهی الکتریکی و با جذب نانو ذرات فاز تقویت‌کننده بر سطح کاتد، برآمدگی‌هایی روی سطح کاتد ایجاد می‌شود و سطح کاتد افزایش می‌یابد. از آنجاکه در اطراف این نانو ذرات برآمده از سطح، چگالی جریان بیشتر است یون‌های نیکل تمایل دارند بر این نانو ذرات رسوب کنند و ساختار نامنظم رشد بیشتری خواهد داشت، به همین دلیل است که با افزایش چگالی جریان ساختاری ناصاف، نامنظم و درشت به دست می‌آید [23].

بررسی اثر چگالی جریان پوشش دهی بر مورفولوژی پوشش‌های تولیدشده

شکل (۶) تصاویر SEM از مورفولوژی سطح پوشش‌های تولیدشده در چگالی جریان‌های مختلف را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل (۶) ملاحظه می‌شود مورفولوژی پوشش شدیداً تابع چگالی جریان پوشش دهی است. افزایش چگالی جریان پوشش دهی باعث تغییر در مورفولوژی پوشش می‌شود. در واقع مورفولوژی پوشش‌ها از سطح تقریباً صاف و هموار در چگالی جریان‌های پایین به مورفولوژی با دانه‌بندی درشت و خشن در چگالی جریان‌های بالا تبدیل می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود در شکل (۶-الف) سطح پوشش دارای دانه‌بندی ریز، فشرده و یکنواخت است. با افزایش چگالی جریان (شکل ۶-ب) رشد دانه‌های گرد



شکل (۶) تصاویر مورفولوژی سطح پوشش کامپوزیتی Ni-Cu-(20 g/l) Al₂O₃ در چگالی جریان‌های

(الف) ۱ A/dm² (ب) ۲ A/dm² (پ) ۳ A/dm² (ت) ۴ A/dm²

رسوب دهی تا ۲ آمپر بر دسی متر مربع ریزسختی پوشش ها افزایش می یابد، اما با افزایش بیشتر چگالی جریان ریز سختی پوشش ها کاهش می یابد. افزایش ریزسختی پوشش ها تا چگالی جریان ۲ آمپر بر دسی متر مربع را می توان به افزایش میزان وارد شدن نانو ذرات سخت اکسید آلومینیوم مطابق با شکل (۳) نسبت داد [25]. در چگالی جریان ۲ آمپر بر دسی متر مربع بیشترین میزان مشارکت نانو ذرات تقویت کننده اکسید آلومینیوم در زمینه پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l)$ Al_2O_3 مشاهده می شود. با افزایش بیشتر چگالی جریان چون از میزان هم رسوبی نانو ذرات در پوشش کاسته می شود، متعاقباً ریزسختی نیز کاهش می یابد. تغییرات مشاهده شده در ریز سختی پوشش های کامپوزیتی ناشی از میزان ورود نانو ذرات در پوشش را می توان طبق مکانیزم استحکام دهی انتشاری توضیح داد [25]. استحکام دهی انتشاری یا رسوب سختی به دلیل ورود نانو ذرات ریز با اندازه کمتر از یک میکرون است [3,26]. نانو ذرات تقویت کننده دارای سختی و مدول الاستیک بالایی نسبت به زمینه می باشند و مطابق با رابطه اوروان (رابطه (۱)) منجر به افزایش استحکام و سختی می شوند [25]:

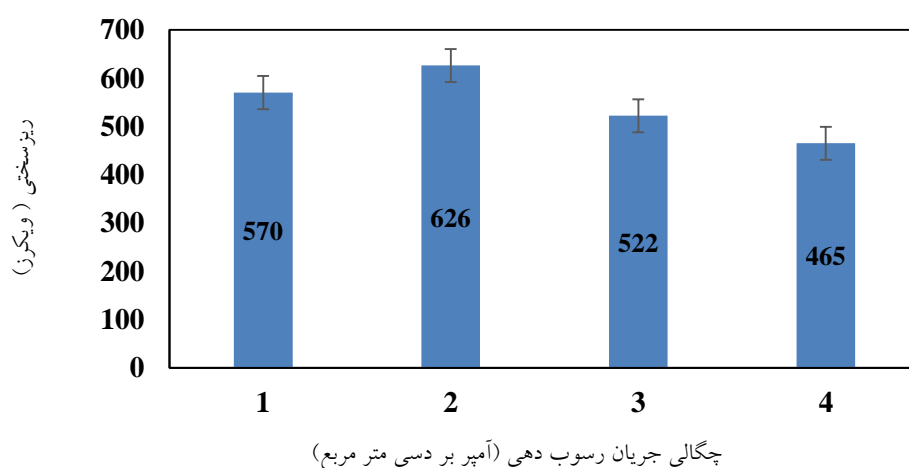
$$\tau_o = \frac{Gb}{\lambda} \quad (1)$$

علت دیگر برای زبر و خشن شدن سطح پوشش تحت چگالی جریان های بالاتر توزیع غیریکنواخت چگالی جریان پوشش دهی به دلیل وجود نانو ذرات است [16]. بین نانو ذرات و زمینه آلیاژی در پوشش اختلاف رسانایی وجود دارد که اختلاف در چگالی جریان رسوب دهی در بخش های مختلف پوشش ایجاد می شود و در بعضی مناطق به طور موضعی چگالی جریان پوشش دهی افزایش می یابد [4]. این اختلاف در چگالی جریان پوشش دهی در چگالی جریان های اعمالی بالاتر، نمایان تر است به طوری که باعث ایجاد مورفولوژی خشن تر نسبت به چگالی جریان های پایین تر می شود [4]. همچنین این تغییر در مورفولوژی سطح با تغییر چگالی جریان را می توان به تغییر در میزان نشست یون های نیکل و مس نسبت داد [24]. مطابق با شکل (۲) با افزایش چگالی جریان و به دنبال آن کاهش مقدار مس، در پوشش ساختاری شبیه گل کلم ظاهر می شود [24].

بررسی اثر چگالی جریان پوشش دهی بر ریزسختی

پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l)$ Al_2O_3

ریزسختی پوشش کامپوزیتی نیکل - مس - اکسید آلومینیوم در چگالی جریان های مختلف در شکل (۷) نشان داده شده است. همان طور که ملاحظه می شود با افزایش چگالی جریان



شکل (۷) اثر چگالی جریان رسوب دهی بر ریزسختی پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l)$ Al_2O_3

مشاهده شده در رفتار خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی تولید شده را با توجه به سه عامل میزان نانو ذرات تقویت کننده در پوشش، ترکیب شیمیایی پوشش و مورفولوژی سطحی می‌توان توضیح داد. حضور نانو ذرات نجیب اکسید آلومینیوم در زمینه آلیاژی پوشش و پوشیده شدن بخشی از سطح پوشش با این نانو ذرات نجیب، مقداری از سطح را که در معرض محیط خورنده قرار می‌گیرد کاهش می‌دهد و نیز این نانو ذرات در شیارها و شکاف‌های میکرونی فرورفته و آن‌ها را پر می‌کنند و باعث بهبود رفتار خوردگی می‌شوند [3,30]. پتانسیل خوردگی مثبت‌تر و چگالی جریان خوردگی پایین‌تر پوشش‌های کامپوزیتی تولید شده در چگالی جریان‌های پایین‌تر در مقایسه با پوشش‌های به دست آمده در چگالی جریان‌های بالاتر نشان از بهبود مقاومت به خوردگی ناشی از حضور و مشارکت بیشتر نانو ذرات آلفا آلومینا دارد [31]. همچنین این نانو ذرات، پتانسیل خوردگی نجیب‌تر و مقاومت به خوردگی بیشتری نسبت به زمینه دارند در نتیجه این نانو ذرات نقش کاتد را ایفا می‌کنند و زمینه اطراف آن‌ها نقش آند را دارد. در نتیجه با تشکیل میکروسف‌های گالوانیک، توزیع خوردگی را در سطح پوشش یکنواخت‌تر می‌کنند و باعث کاهش خوردگی موضعی می‌شوند و به طور کلی خوردگی یکنواخت و همگنی رخ می‌دهد و در نتیجه مقاومت به خوردگی افزایش می‌یابد [30]. ترکیب شیمیایی پوشش هم بر رفتار خوردگی تأثیرگذار است [32]. کاهش مشاهده شده در مقاومت به خوردگی پوشش‌های تولید شده را نیز می‌توان به کاهش مقدار درصد وزنی مس در پوشش‌ها با افزایش در چگالی جریان نسبت داد. در واقع عناصر آلیاژی نجیب‌تر نسبت به زمینه نیکلی مقاومت به خوردگی آن‌ها را بهبود می‌دهند [32]. همان‌طور که گفته شد عامل دیگر که بر خواص خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی تأثیرگذار است مورفولوژی سطح پوشش است. همان‌طور که در شکل (۶) دیده می‌شود با افزایش چگالی جریان سرعت رشد مناطق گل کلمی زیاد می‌شود و شاهد یک مورفولوژی زبر و خشن هستیم. در این حالت یون‌های خورنده کلر (Cl^-) می‌توانند

در رابطه (۱)، τ_0 تنش برشی، λ فاصله بین دو ذره تقویت کننده، b بردار برگرز زمینه میان دو ذره و G مدول برشی زمینه است [25]. نانو ذرات تقویت کننده اکسید آلومینیوم به عنوان فازهای سخت در پوشش مانع حرکت نابجایی‌ها می‌شوند و در نتیجه استحکام و ریزسختی پوشش افزایش می‌یابد [27]. با افزایش مقدار نانو ذرات فاز تقویت کننده و پراکندگی مناسب این نانو ذرات در زمینه، فاصله بین این نانو ذرات (λ) کاهش می‌یابد و استحکام و ریزسختی پوشش افزایش می‌یابد [25]. با افزایش چگالی جریان رسوب دهی تا ۲ آمپر بر دسی متر مربع و افزایش میزان هم رسوبی نانو ذرات در زمینه آلیاژی پوشش، ریزسختی تا مقدار ۶۲۶ ویکرز افزایش می‌یابد. کاهش ریزسختی پوشش‌ها می‌تواند به دلیل کاهش درصد مشارکت نانو ذرات اکسید آلومینیوم در این پوشش‌ها باشد [28,29].

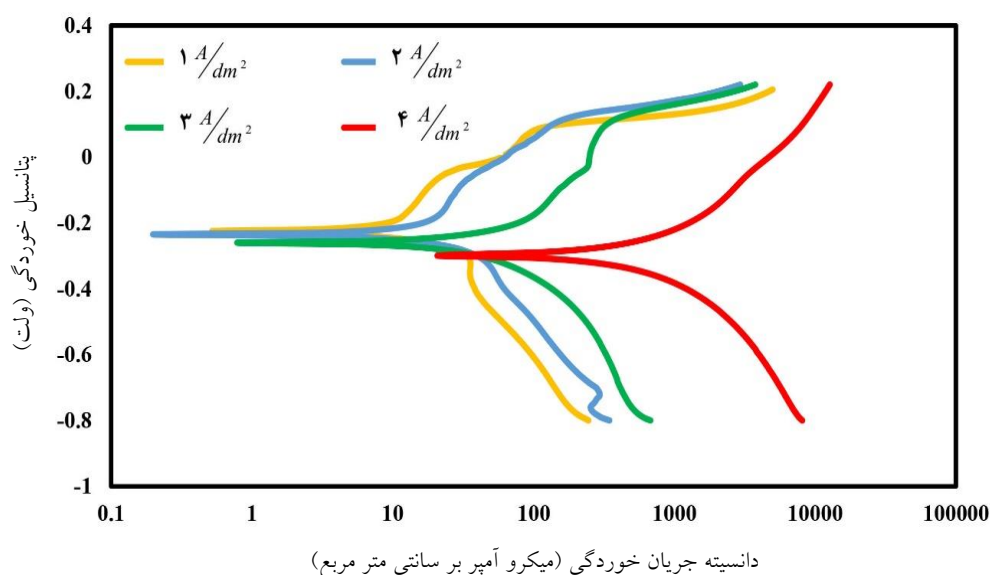
بررسی اثر چگالی جریان پوشش دهی بر رفتار خوردگی

پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3$

جهت بررسی اثر چگالی جریان رسوب دهی بر رفتار خوردگی پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3$ آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک بر روی پوشش‌ها انجام گرفت. شکل (۸) نمودار پلاریزاسیون پتانسیودینامیک پوشش‌ها در محلول ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم را نشان می‌دهد. داده‌های حاصل از آزمون‌های خوردگی در جدول (۳) آورده شده است. همان‌طور که در نمودار پلاریزاسیون مشاهده می‌شود و از نتایج به دست آمده در جدول (۳) مشخص است با افزایش چگالی جریان رسوب دهی، پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر منفی انتقال پیدا کرده و چگالی جریان خوردگی افزایش یافته است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3$ تولید شده تحت چگالی جریان رسوب دهی ۱ آمپر بر دسی متر مربع در مقایسه با سایر پوشش‌ها پتانسیل خوردگی مثبت‌تر و چگالی جریان خوردگی کمتری دارد که نشان از مقاومت به خوردگی بهتر این پوشش نسبت به پوشش‌های دیگر دارد. تغییرات

پتانسیل خوردگی در میان پوشش های تولید شده، مربوط به پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3$ در چگالی جریان ۴ آمپر بر دسی متر مربع است. کم تر بودن پتانسیل خوردگی در این پوشش را می توان به مورفولوژی سطحی این پوشش نسبت داد. مورفولوژی این پوشش دارای یک سری حفره های سطحی است. این در حالی است که درون این حفرات احتمال رسیدن ماده خورنده به زیر لایه زیاد می شود در نتیجه باعث منفی تر شدن پتانسیل خوردگی و به دنبال آن کاهش مقاومت به خوردگی می شود [34].

راحت تر نفوذ کنند و فضای بیشتری برای حمله داشته باشند در نتیجه باعث افزایش نرخ انحلال سطح و کاهش مقاومت به خوردگی می شوند [33]. همان طور که در شکل (۸) و جدول (۳) مشخص است پوشش تولید شده در چگالی جریان ۱ آمپر بر دسی متر مربع نسبت به پوشش تولید شده در چگالی جریان ۲ آمپر بر دسی متر مربع در حالی که درصد هم رسوبی نانو ذرات اکسید آلومینیوم کمتری دارد، رفتار خوردگی بهتر از خود نشان داده است. این تغییر رفتار خوردگی را می توان به بیشتر بودن درصد وزنی عنصر نجیب مس و داشتن مورفولوژی سطحی صاف و هموارتر نسبت داد. منفی ترین



شکل (۸) نمودار پلاریزاسیون پتانسیودینامیک پوشش کامپوزیتی $Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3$ در چگالی جریان های رسوب دهی مختلف

جدول (۳) نتایج حاصل از آزمون خوردگی در محیط ۳/۵ درصد وزنی کلرید سدیم

پوشش	چگالی جریان پوشش دهی (A/dm^2)	پتانسیل خوردگی (mv)	چگالی جریان خوردگی ($\mu A/cm^2$)
Ni-Cu-(20g/l) Al_2O_3	۱	-۲۲۵	۰/۳۴۲
	۲	-۲۳۵	۱/۱۱
	۳	-۲۶۰	۲/۷۴
	۴	-۳۰۰	۷۳/۲

نتیجه گیری

در پوشش‌ها به ترتیب افزایش و کاهش یافت.
 ۵. بررسی توزیع عناصر در سطح پوشش ایجادشده توزیع یکنواخت و مناسب از عناصر نیکل، مس و نانو ذرات اکسید آلومینیوم را نشان داد.
 ۶. با افزایش چگالی جریان رسوب‌دهی ریزسختی پوشش‌های تولیدشده ابتدا افزایش سپس کاهش یافت.
 ۷. مقاومت به خوردگی پوشش‌های کامپوزیتی تولیدشده با افزایش چگالی جریان رسوب‌دهی کاهش پیدا کرد.

۱. پوشش آلیاژی نیکل-مس-اکسید آلومینیوم به‌طور موفقیت‌آمیز توسط روش رسوب‌دهی الکتریکی تولید شد.
 ۲. با افزایش چگالی جریان رسوب‌دهی مورفولوژی پوشش‌ها تغییر کرد و ناهمواری‌های سطح افزایش پیدا کرد.
 ۳. میزان مشارکت نانو ذرات اکسید آلومینیوم در پوشش کامپوزیتی، با افزایش چگالی جریان رسوب‌دهی ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت.
 ۴. با افزایش چگالی جریان مقدار در صد وزنی نیکل و مس

مراجع

1. Bagheri, P., Farzam, M., Mousavi, A., and Hosseini, M., "Ni-TiO₂ nanocomposite coating with high resistance to corrosion and wear," *Surface and Coatings Technology*, vol. 204, pp. 3804-3810, (2010).
2. Zhang, Y.-h., Ding, G.-f., Cai, Wang, H., and Cai, B., "Electroplating of low stress permalloy for MEMS," *Materials characterization*, vol. 57, pp. 121-126, (2006).
3. Gül, H., Kılıç, F., Aslan, S., Alp, A., and Akbulut, H., "Characteristics of electro-co-deposited Ni- Al₂O₃ nano-particle reinforced metal matrix composite (MMC) coatings," *Wear*, vol. 267, pp. 976- 990, (2009).
4. Rudnik, E., Burzyńska, L., Dolasiński, Ł., and Misiak, M., "Electrodeposition of nickel/SiC composites in the presence of cetyltrimethylammonium bromide," *Applied Surface Science*, vol. 256, pp. 7414-7420, (2010).
5. ZHENG, H., Maozhong, A., and Junfeng, L., "Corrosion behavior of Zn-Ni-Al₂O₃ composite coating," *Rare Metals*, vol. 25, pp. 174-178, (2006).
6. Baskaran, I., Narayanan, T. S., and Stephen, A., "Pulsed electrodeposition of nanocrystalline Cu-Ni alloy films and evaluation of their characteristic properties", *Materials Letters*, vol. 60, pp. 1990- 1995, (2006).
7. Yao, Y., Yao, S., Zhang, L., and Wang, H., "Electrodeposition and mechanical and corrosion resistance properties of Ni-W/SiC nanocomposite coatings", *Materials Letters*, vol. 61, pp. 67-70, (2007).
8. Saranya, D., Velayutham, D., and Suryanarayanan, V., "Electrodeposition of Ni-Cu alloys from a protic ionic liquid medium-voltammetric and surface morphologic studies", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, vol. 734, pp. 70-78, (2014).
9. Lee, H.-K., Lee, H.-Y., and Jeon, J.-M. "Codeposition of micro-and nano-sized SiC particles in the nickel matrix composite coatings obtained by electroplating", *Surface and Coatings Technology*, vol. 201, pp. 4711-4717, (2007).
10. Sarac, U., Öksüzöğlü, R. M., and Baykul, M. C., "Deposition potential dependence of composition, microstructure, and surface morphology of electrodeposited Ni-Cu alloy films", *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, vol. 23, pp. 2110-2116, (2012).

11. Goranova, D., Avdeev, G., and Rashkov, R., "Electrodeposition and characterization of Ni–Cu alloys", *Surface and Coatings Technology*, vol. 240, pp. 204-210, (2014).
12. Beltowska-Lehman, E., Indyka, P., Bigos, A., Szczerba, M., Guspiel, J., Koscielny, H., *et al.*, "Effect of current density on properties of Ni–W nanocomposite coatings reinforced with zirconia particles", *Materials Chemistry and Physics*, vol. 173, pp. 524-533, (2016)
13. Wang, S., Guo, X., Yang, H., Dai, J., Zhu, R., Gong, J., *et al.*, "Electrodeposition mechanism and characterization of Ni–Cu alloy coatings from a eutectic-based ionic liquid", *Applied Surface Science*, vol. 288, pp. 530-536, (2014).
14. Sarac, U., and Baykul, M. C., "Morphological and microstructural properties of two-phase Ni–Cu films electrodeposited at different electrolyte temperatures," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 552, pp. 195-201, (2013).
15. Calleja, P., Esteve, J., Cojocar, P., Magagnin, L., Valles, E., and Gomez, E., "Developing plating baths for the production of reflective Ni–Cu films", *Electrochimica Acta*, vol. 62, pp. 381-389, (2012).
16. Guo, C., Zuo, Y., Zhao, X., Zhao, J., and Xiong, J., "The effects of electrodeposition current density on properties of Ni–CNTs composite coatings", *Surface and Coatings Technology*, vol. 202, pp. 3246-3250, (2008).
17. Srinivas, P., Hamann, S., Wambach, M., Kieschnick, M., Ludwig, A., and Dey, S. R., "Development of Ni–Cu Materials Library by Using Combinatorial Pulsed Electrodeposition", *Transactions of the Indian Institute of Metals*, vol. 66, pp. 429-432, (2013).
18. Saha, R., and Khan, T., "Effect of applied current on the electrodeposited Ni– Al_2O_3 composite coatings", *Surface and Coatings Technology*, vol. 205, pp. 890-895, (2010).
19. Tripathi, v, and Singh, V., "Properties of electrodeposited functional Ni–Fe/AlN nanocomposite coatings," *Arabian Journal of Chemistry*, (2015).
20. Beltowska-Lehman, E., Indyka, P., Bigos, A., Szczerba, M., Guspiel, J., Koscielny, H., *et al.*, "Effect of current density on properties of Ni–W nanocomposite coatings reinforced with zirconia particles", *Materials Chemistry and Physics*, vol. 173, pp. 524-533, (2016).
21. Gyawali, G., Cho, S. H., and Lee, S. W., "Electrodeposition and characterization of Ni-TiB₂ composite coatings", *Metals and Materials International*, vol. 19, pp. 113-118, (2013).
22. Tamilarasan, T., Rajendran, R., Rajagopal, G., and Sudagar, J., "Effect of surfactants on the coating properties and corrosion behaviour of Ni–P–nano-TiO₂ coatings," *Surface and Coatings Technology*, vol. 276, pp. 320-326, (2015).
23. Vázquez-Gómez, L., Cattarin, S., Guerriero, P., and Musiani, M., "Influence of deposition current density on the composition and properties of electrodeposited Ni+RuO₂ and Ni+IrO₂ composites", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, vol. 634, pp. 42-48, (2009).
24. Haciismailoglu, M., and Alper, M., "Effect of electrolyte pH and Cu concentration on microstructure of

- electrodeposited Ni-Cu alloy films", *Surface and Coatings Technology*, vol. 206, pp. 1430-1438, (2011).
25. Hou, F., Wang, W., and Guo, H., "Effect of the dispersibility of ZrO₂ nanoparticles in Ni-ZrO₂ electroplated nanocomposite coatings on the mechanical properties of nanocomposite coatings", *Applied Surface Science*, vol. 252, pp. 3812-3817, (2006).
 26. Goldasteh, H., and Rastegari, S., "The influence of pulse plating parameters on structure and properties of Ni-W-TiO₂ nanocomposite coatings", *Surface and Coatings Technology*, vol. 259, pp. 393-400, (2014).
 27. Pavlatou, E., Stroumbouli, M., Gyftou, P., and Spyrellis, N., "Hardening effect induced by incorporation of SiC particles in nickel electrodeposits", *Journal of Applied Electrochemistry*, vol. 36, pp. 385-394, (2006).
 28. Wang, Y., Zhou, Q., Li, K., Zhong, Q., and Bui, Q. B., "Preparation of Ni-W-SiO₂ nanocomposite coating and evaluation of its hardness and corrosion resistance", *Ceramics International*, vol. 41, pp. 79-84, (2015).
 29. Lajevardi, S., and Shahrabi, T., "Effects of pulse electrodeposition parameters on the properties of Ni-TiO₂ nanocomposite coatings", *Applied Surface Science*, vol. 256, pp. 6775-6781, (2010).
 30. Allahyarzadeh, M., Aliofkhaeaei, M., Rouhaghdam, A. S., and Torabinejad, V., "Electrodeposition of Ni-W-Al₂O₃ nanocomposite coating with functionally graded microstructure", *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 666, pp. 217-226, (2016).
 31. Shakoor, R., Kahraman, R., Waware, U., Wang, Y., and Gao, W., "Properties of electrodeposited Ni-B-Al₂O₃ composite coatings", *Materials & Design*, vol. 64, pp. 127-135, (2014).
 32. Bakhit, B., Akbari, A., Nasirpouri, F., and Hosseini, M. G., "Corrosion resistance of Ni-Co alloy and Ni-Co/SiC nanocomposite coatings electrodeposited by sediment codeposition technique", *Applied Surface Science*, vol. 307, pp. 351-359, (2014).
 33. Ghosh, S., Dey, G., Dusane, R., and Grover, A., "Improved pitting corrosion behaviour of electrodeposited nanocrystalline Ni-Cu alloys in 3.0 wt.% NaCl solution", *Journal of alloys and compounds*, vol. 426, pp. 235-243, (2006).
 34. Huang, P.-C., Hou, K.-H., Wang, G.-L., Chen, M.-L., and Wang, J.-R., "Corrosion Resistance of the Ni-Mo Alloy Coatings Related to Coating's Electroplating Parameters", *International Journal of Electrochemical Science*, vol. 10, pp. 4972-4984, (2015).

